

Title (en)  
MODULE MOUNTING ASSEMBLY.

Title (de)  
MODULZUSAMMENBAUEINHEIT.

Title (fr)  
ASSEMBLAGE DE MONTAGE DE MODULE.

Publication  
**EP 0124593 A1 19841114 (EN)**

Application  
**EP 83903743 A 19831101**

Priority  
US 43938982 A 19821105

Abstract (en)  
[origin: WO8401859A1] Apparatus for mounting an integrated circuit module (2) on a printed wiring circuit board (3). The apparatus assembly (1) comprises a ring member (13) for use in assembling a generally rectangular insulating member (11) having a plurality of electrical conducting members (10) positioned therein with a plurality of other insulating members (12) to form quadrilateral configurations of first and second contacts (101, 102) for contacting module terminals (20) and the printed wiring circuit board. A one piece cover (14) engages the ring member to spring clamp the module on the rectangular insulating member and maintain each module terminal in engagement with a corresponding first contact to electrically couple the module with the printed wiring circuit board.

Abstract (fr)  
Dispositif de montage d'un module de circuit intégré (2) sur une plaque de circuit imprimé de câblage (3). L'assemblage du dispositif (1) comprend un organe annulaire (13) destiné à être utilisé pour assembler un organe isolant généralement rectangulaire (11) dans lequel sont positionnés une pluralité d'organes conducteurs électriques (10) avec une pluralité d'autres organes isolants (12) pour former des configurations quadrilataires de premier et de deuxième contacts (101, 102) permettant d'établir des contacts entre les terminaux du module (20) et la plaque de circuit imprimé de câblage. Un couvercle monobloc (14) engage l'organe annulaire pour serrer élastiquement le module contre l'organe isolant rectangulaire et maintenir chaque terminal de module en engagement avec un premier contact correspondant de manière à coupler électriquement le module avec la plaque de circuit imprimé de câblage.

IPC 1-7  
**H01R 23/72**

IPC 8 full level  
**H05K 7/10** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**H05K 7/1069** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8401859 A1 19840510**; EP 0124593 A1 19841114; EP 0124593 A4 19870129

DOCDB simple family (application)  
**US 8301692 W 19831101**; EP 83903743 A 19831101